

MMGL Series

This machine is free-shape scriber using green laser with laser plasma micro processing.

グリーンレーザーを用いたレーザプラズママイクロ加工による
ガラス穴あけ加工機。

- It can do laser drilling, circumference R cutting and straight cutting.
- This machine is equipped with multiple head for high productivity.
- 穴加工や外周加工が可能。
- マルチヘッド搭載による高生産性を実現。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

Multi-Head Laser Drilling Machine

グリーンレーザードリリング装置 MMGL シリーズ

MMGL Series

Specifications

MODEL		MMGL500	
Glass Size	対応基板サイズ		500mm×500mmMAX
Glass Thickness	対応基板厚み	Single Substrate / 単板	~t1.8mm
Head Movement Velocity	ヘッド送り速度		500mm/secMAX
Positioning Precision	加工位置精度	Center position accuracy / 中心位置精度	±25μm
		accuracy of the hole shape / 穴形状精度	±25μm
Dimensions(W×D×H)	装置寸法		2,200×2,000×1,800mm
Weight	重量		approx. 3,000kg

Hi-CT Glass Drilling

Substrate: Hi-CT Glass
Thickness: t0.7mm
DOL: 20μm
Diameter: φ10mm

基板：Hi-CT Glass
板厚：t 0.7mm
DOL：20μm
穴径：φ 10mm



- MMGL series enable drilling and circumference R cutting of Hi-CT glass which is used for a smartphone display.
- Using a picosecond green laser can make it possible to cut Hi-CT glass with chipping below 30μm.
- You can cut in any shape like round, ellipse, square, etc.
- スマートフォンのカバーガラスに用いられる Hi-CT ガラスに対し、穴あけ加工と外形コーナー部分に R 加工しました。
- ピコ秒グリーンレーザを用いることによりチッピングサイズ 30μm 以下で加工することが可能です。
- 加工形状は丸穴、楕円、四角など自由に選択することが可能です。

Hi-CT Glass Drilling

Substrate: Alkali-free Glass
Thickness: t0.2mm

基板：無アルカリガラス
板厚：t 0.2mm



- MMGL series enable free-shape cutting of alkali-free glass which is used for LCD.
- Using a picosecond green laser can make it possible to cut alkali-free glass with chipping below 30μm.
- You can cut in any shape.
- 液晶パネルに用いられる無アルカリガラスに対し、外形を自由形状で切り取り加工しました。
- レーザはピコ秒グリーンレーザを使用し、チッピングサイズ 30μm 以下で加工することが可能です。
- 加工形状は自由に選択することが可能です。

Contact

www.mitsuboshidiamond.com

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.

※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.

※記載された仕様は予告なく変更することがあります。

MDI
MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.